



***Fine
M-Tec***

융복합 기술과 최고의 메커니즘으로 미래를 선도하는 IT부품기업

**Foldable Tech
Hybrid Precision Machining
Advanced Mechanisms**

One-stop manufacturing services and solutions for precision functional parts, structural parts, modules

**FINE M-TEC 2025
Investor Relations**

2025. 05.

KOSDAQ 441270 FINE M-TEC CO.,LTD. 2025 © All Rights Reserved

DISCLAIMER

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 프레젠테이션에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 파인엠텍 (이하 "회사")에 의해 작성되었으며
이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료에 포함된 회사의 재무성과에 대한 모든 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 기준으로 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로
회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은
"예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 프레젠테이션 실시일 현재를 기준으로 작성된 것으로, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로
향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가
될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 투자자의 합리적인 판단에 의하여 이루어져야만 합니다.

회사개요 및 연혁

회사개요

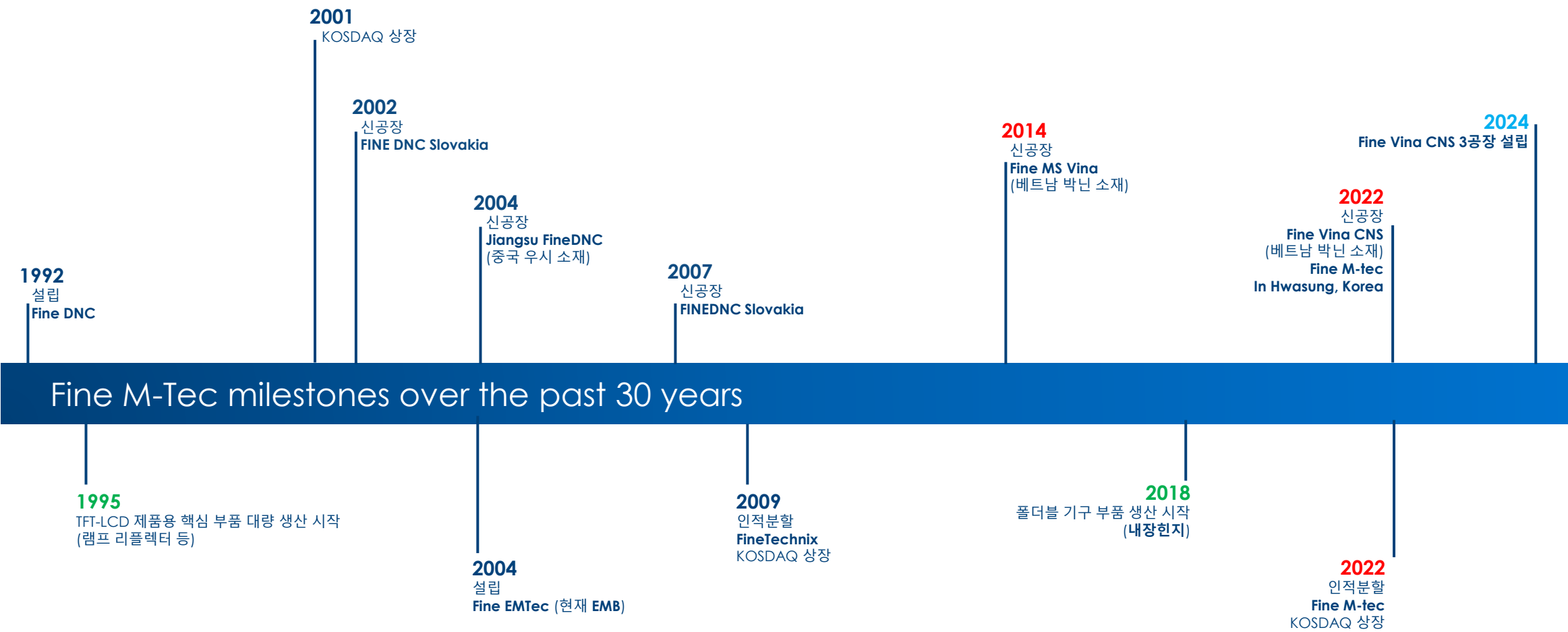
회사명	주식회사 파인엠텍
대표이사	이 재 규
설립일	2022년 9월 1일 *주식회사 파인테크닉스로부터 인적분할 설립
상장일	2022년 10월 7일
자본금	18,494 백만원
직원수	국내 120명, 해외 1,700명
사업영역	기구부품 제조(폴더블폰 부품, 자동차 부품 등)
본사주소	경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 파인엠텍
홈페이지	https://finemtec.com

*상기사항은 2025년 3월 31일 기준이며, 별도의 표시가 없는 경우 연결기준입니다.

연혁

- 1992 회사설립 ((주)파인디앤씨)
- 1996 삼성전자 LCD총괄(現 삼성디스플레이) 협력사 등록, 벤처기업 인증
- 2000 회사이전 : 경기도 안양 (안양동 203-9,10 / 現 (주)파인테크닉스 제1공장)
- 2001 공장증설 : 경기도 안양 (안양동 203-3 / 現 (주)파인테크닉스 제2공장)
- 2008 모바일 IT힌지부품 개발·양산 (슬라이더블,폴더블)
- 2009 (주)파인테크닉스 인적분할 설립 (경기도 안양) - LED조명 및 IT부품 제조, 코스닥 상장
- 2012 다이캐스팅 공정 구축완료(Al, Mg, Zn)
- 2013 다이캐스팅 양산 개시 (자동차 및 IT부품)
- 2014 베트남 현지법인 "FINE MS VINA" 설립 (베트남 박닌 소재)
- 2018 베트남 현지법인 "FINE MS VINA" 2공장 증축
- 2019 폴더블폰 부품 개발 완료 및 고객사 단독 납품 개시
- 2020 (주)파인테크닉스 본점 신규사옥 이전 (안양시 만안구)
- 2021 베트남 현지법인 "VINA CNS"설립 (베트남 박닌 소재)
- 2022 인적분할 예비심사 승인 및 증권신고서 효력발생
(분할기일: 9월1일, 존속: LED조명사업(파인테크닉스) / 신설: IT부품사업(파인엠텍)
화성사업장 이전 확장 (EV부품 주력생산)
- 2023 "VINA CNS"법인 3공장 착공 (EV부품 및 힌지 사업 확장)
EV Battery 기구부품 개발·양산
- 2024 "VINA CNS"법인 3공장 준공완료

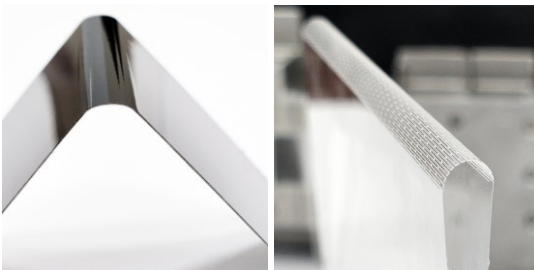
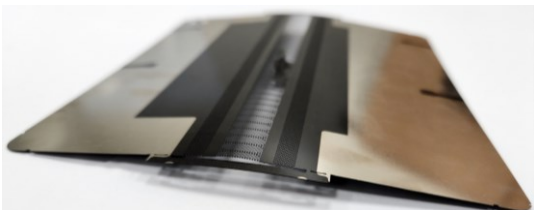
파인엠텍의 30년 역사



주요제품소개

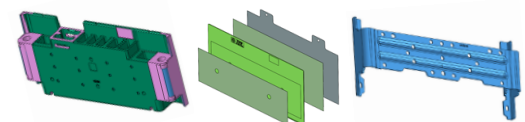
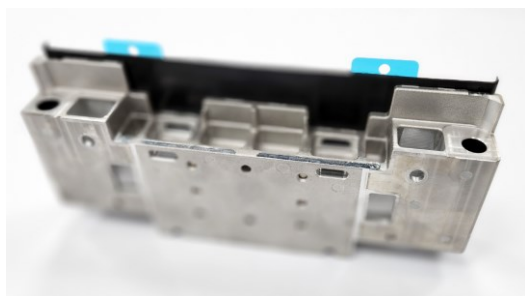
폴더블 디스플레이 부품

폴더블 디스플레이 가이드 플레이트
SUS, CFRP, Ti, GMF 등 소재다변화



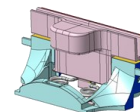
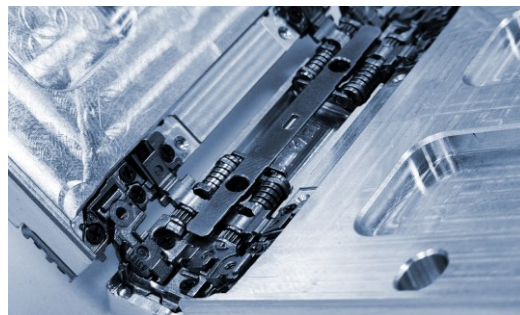
2차전지 모듈 부품

전기차 전지 및 ESS 전지 구조부품



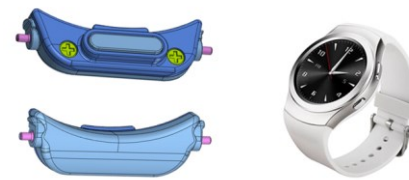
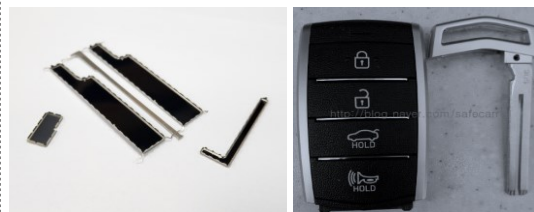
Hinge 기구 부품

폴더블 디바이스 힌지 기구부품
-폴더블폰, 폴더블 게임기 등 적용 가능



기타 융복합 기구부품

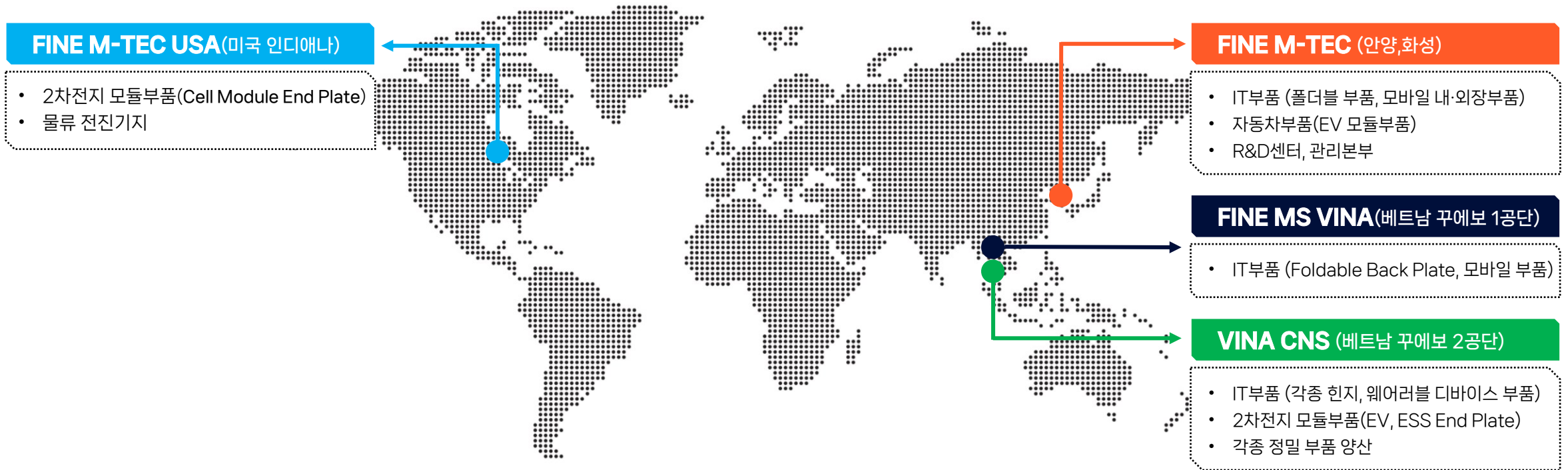
그 외 각종 차량용 기구부품,
웨어러블 디바이스용 소형정밀 기구부품 등



*상기 이미지는 이해를 돕기 위한 예시로, 고객사 NDA(비밀유지계약) 준수를 위해 실제 부품 이미지와 상이합니다.

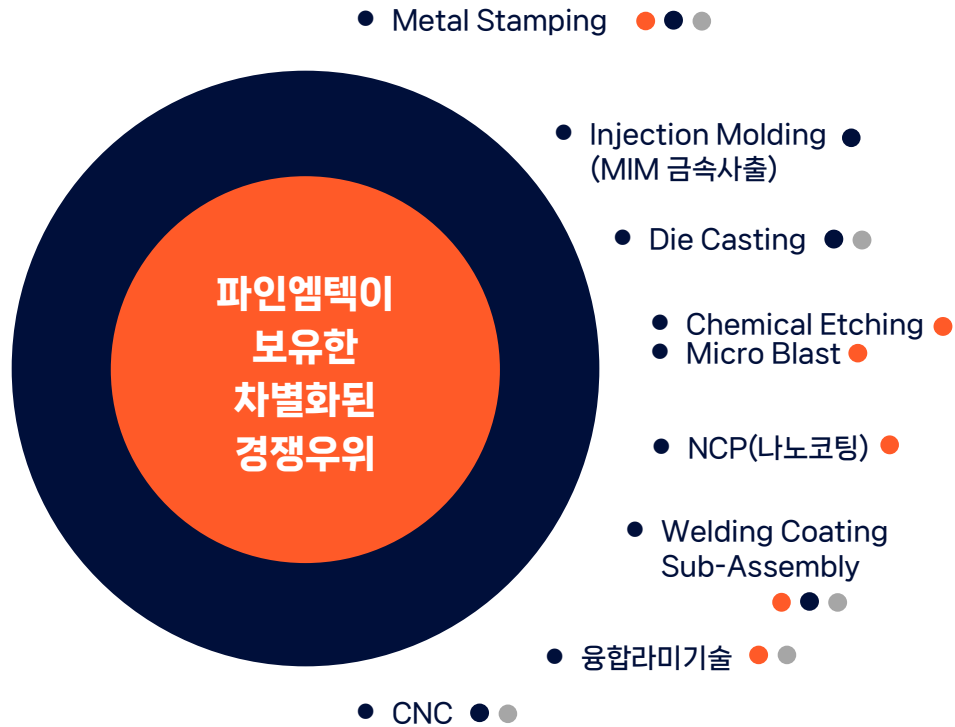
글로벌 파인엠텍

국내 R&D의 혁신적 기술개발과 해외 생산기지를 통한 전략적 사업확장

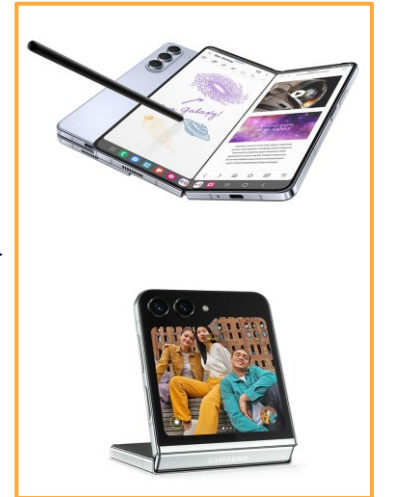
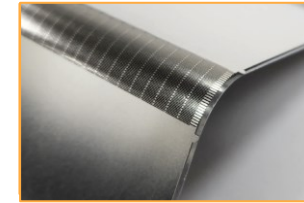


보유 기술

다양한 기구부품·모듈을 공급할 수 있는 융복합 제조기술 보유



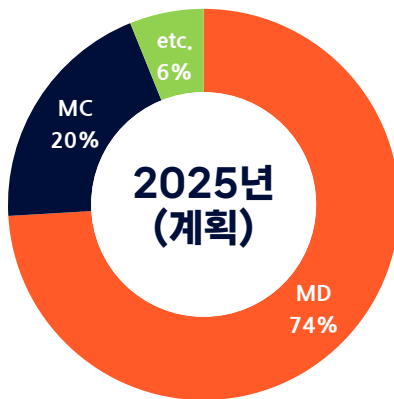
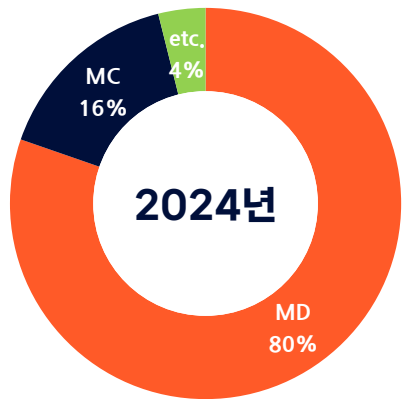
- 폴더블 플레이트
- 정밀기구부품, 모듈부품
- End-Plate 등 차량용 부품



*상기 이미지는 이해를 돕기 위한 예시로, 고객사(NDA(비밀유지계약)) 준수를 위해 실제 부품 이미지와 상이합니다.

사업 부문별 전략

.....▶ 기술력 강화 및 사업다각화로 성장과 지속경영 도모



2025년 전망

- MX향 출하량 전년 대비 소폭 증가 예상
- 수율 개선 및 공정 자동화 확대로 마진율 회복 전망, 다만 신규 모델 개발 투자 증가로 일부 상쇄예상
- EV시장 변동성 대비 포트폴리오 다각화, 신규 제품군 확장을 통해 지속적인 성장 모멘텀 확보

MD부문 (폴더블)

차세대 폴더블 디스플레이 대응 기술 확보

- MX향 폴더블폰 라인업 확대에 따른 매출 증가 기대
- 플렉서블 플레이트 신소재 개발 및 경량화 기술 적용으로 경쟁력 강화
- 글로벌 브랜드 폴더블 시장 진입 가시화
- 차세대 폴더블 디바이스용 커버글라스 부문 진출

MC부문 (기구부품)

차세대 폴더블 디스플레이 대응 기술 확보

- End Plate부문 ESS분야로 매출 확대 전망
- MIM공정 기반 신규 아이템 준비중, 연말 시장 진입 기대
- 폴더블·차량용 등 다분야 힌지 모듈과 웨어러블 디바이스용 기구부품 등 다양한 아이템 및 매출처 확대

01 폴더블 디스플레이

- 폴더블 디바이스용 복합소재 Plate 및 관련부품

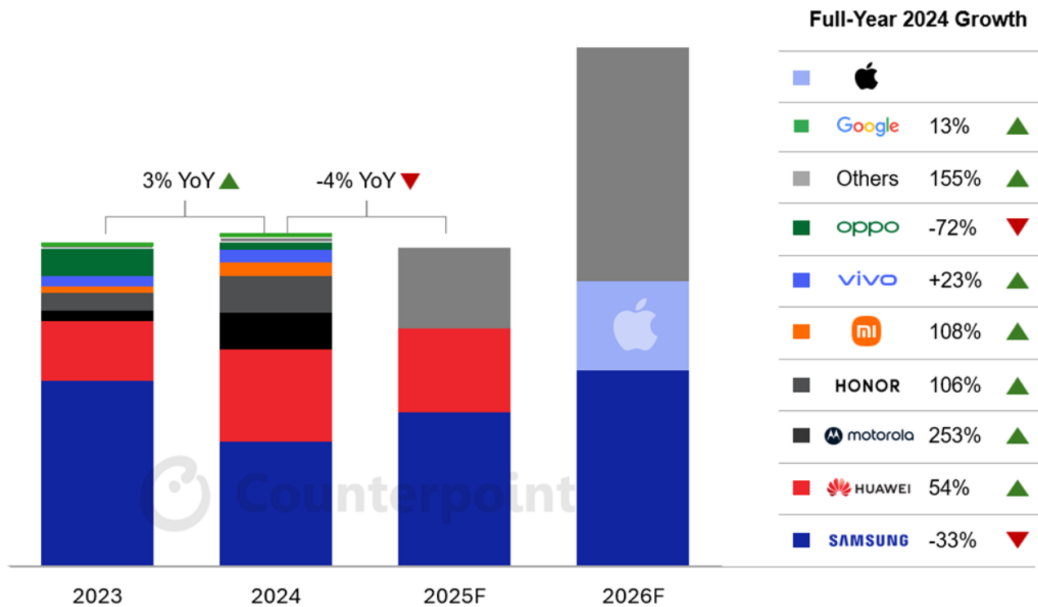


Foldable Back Plate

글로벌 폴더블폰 시장 전망 및 전략적 포지셔닝

2025년 글로벌 수요 – 성장 둔화, '26년은 개화의 시작

- Counterpoint Research: 2025년 폴더블 출하량 한 자릿수 감소 예상
- 고가 부담 · 교체주기 장기화 · 재고조정 → 성장 조정 국면
- 2026년 애플 시장 진출 기대



출처: 카운터포인트리서치

'25년 고객사 라인업 전망 & 대응

- 차세대 북타입: 주름 · 두께 · 무게 개선 → 프리미엄 수요 유지 예상
- 보급형 클램셀(예정): 가격 진입장벽 완화 → 신규 수요 창출 기대
- MX, "2025년 폴더블 스마트폰 UX혁신으로 경쟁우위 점할 것"

파인엠텍의 기술 리더십

- 누적 4,740만 세트 양산 경험에 기반한 독보적 양산 기술력
- 폴더블 1세대부터 현재까지 고수율 유지 성공 사례
- 고객사와의 공동 기술개발을 통한 장기적 신뢰관계 구축
- 차세대 제품 개발을 위한 지속적 R&D 투자

'대량 양산 품질'로 기회 확대



이미지출처: 삼성전자, Fold 6 SE

Production Facility

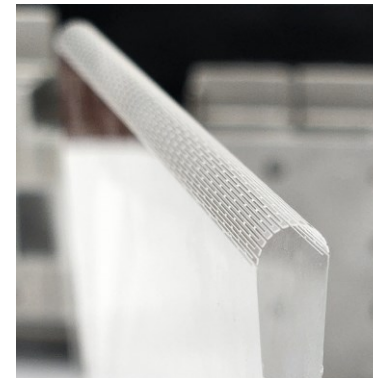
MS VINA 시설 소개

- 대지면적 20,000㎡(6,000평)
- Back Plate Ass'y, 모바일 부품 등 생산
- Etching, Micro Blast, Forming Press, 사출기 등 설비 보유
- Foldable 내장Hinge 자동화 생산/검사(AOI) Line 보유

경쟁력

- Ti Alloy 소재 가공 기술 국산화, 가격·품질 경쟁력 확보
- 친환경 나노 코팅 표면 처리 기법을 통한 EMI Solution 확보
- Metal(SUS, AL 등) 및 비 Metal(CFRP, GFRP) 가공 기술
- Plate가공 전 공정 내제화를 통한 원가 경쟁력 확보
- 커버 글라스 가공을 위한 신규 Etching 공정 진행
- Etching 및 Laser가공기술 기반 차기 플레이트 공정 진행

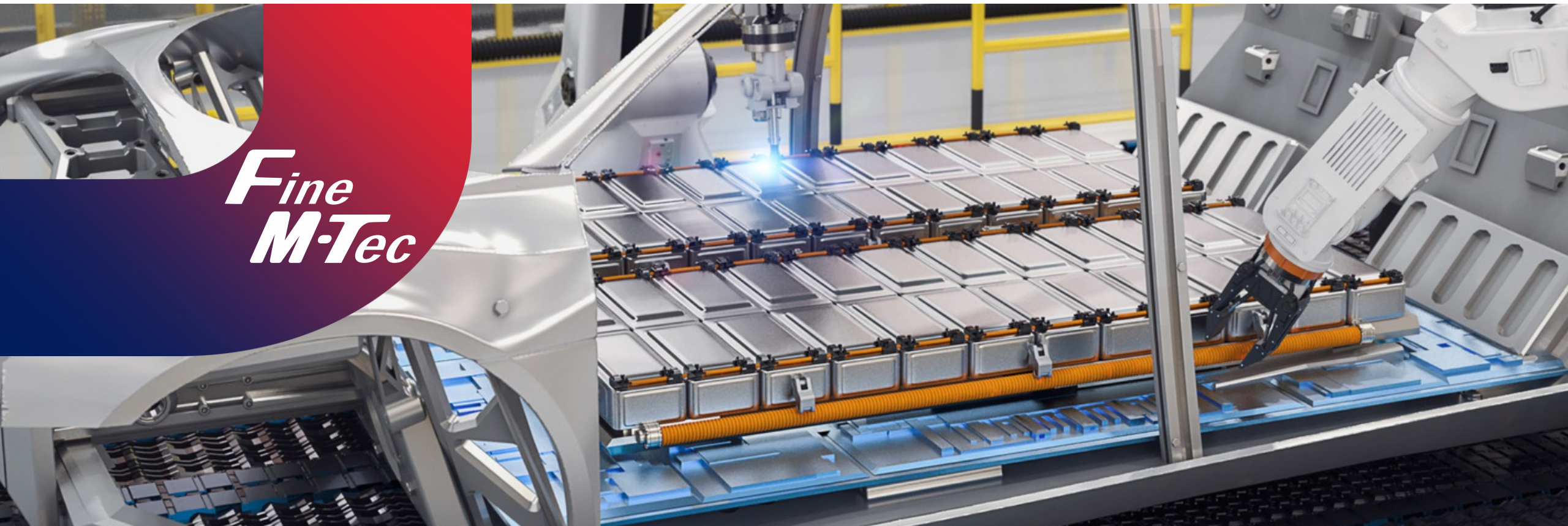
- 국내 - 안양 사업장
- 베트남 MS VINA - 박닌성 꾸에보 1공단 소재



MS VINA 전경 (베트남)

02 자동차분야 기구부품

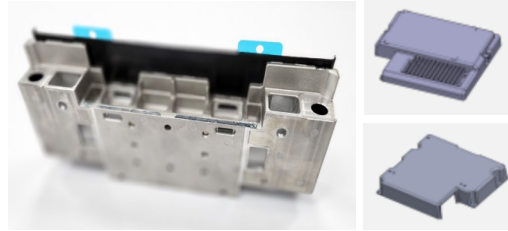
- 2차전지 기구부품, 차량 전장 기구부품



2차전지 모듈부품, 차량 기구부품

2차전지 모듈부품 (End-Plate)

- EV 배터리 모듈용 양산 → 3Q25부터 ESS 전용 End-Plate 신규 양산 예정
- EV용 End-Plate → 수요 둔화에 따른 단기 발주 위축, 장기 성장 전망은 유지



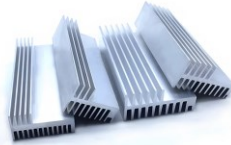
자동차 전장 디스플레이, 다이내믹 기구부품

- 차량용 접이식 테이블 → 26년 하반기 양산 예정
- 차량 인포테인먼트 디스플레이 메커니즘 개발 진행 중



자동차 구조부품 정밀 · 다이내믹 기구부품

- 헤드라이트 하우징, 히트싱크
- 대시보드 플레이트, 네비게이션 하우징, 스마트 키 Set 등 차량용 기구부품 양산



추진사항

2차전지 부품분야 확장

- End-Plate 외 Case Top, Case Bottom 등 모듈부품 수주 추진
- 최종고객사(완성차 제조사) 다각화 추진

*상기 이미지는 이해를 돕기 위한 예시로, 고객사(NDA(비밀유지계약) 준수)를 위해 실제 부품 이미지와 상이합니다.

Production Facility

- 베트남 VINA CNS - 박닌성 꾸에보 2공단 소재

VINA CNS 시설 소개

- 대지면적 50,000m²(15,000평)
- Hinge Module Ass'y, EV Module Housing 등 생산
- 사출기 20대, 다이캐스팅 22대, CNC 106대 등 설비 보유
- 생산량 증가에 따른 생산동(3공장) 2024년 중순 셋업 완료예정
*(연면적 30,000m²/9,090평)

경쟁력

- 금속시트 정밀 · 고속가공 기술인 메탈스탬핑 공법적용
- 다이캐스팅, CNC, 융복합소재 활용한 첨단제조설비를 통해 전장품 모듈 A'ssy 최적화 시설보유



VINA CNS 전경 (베트남)

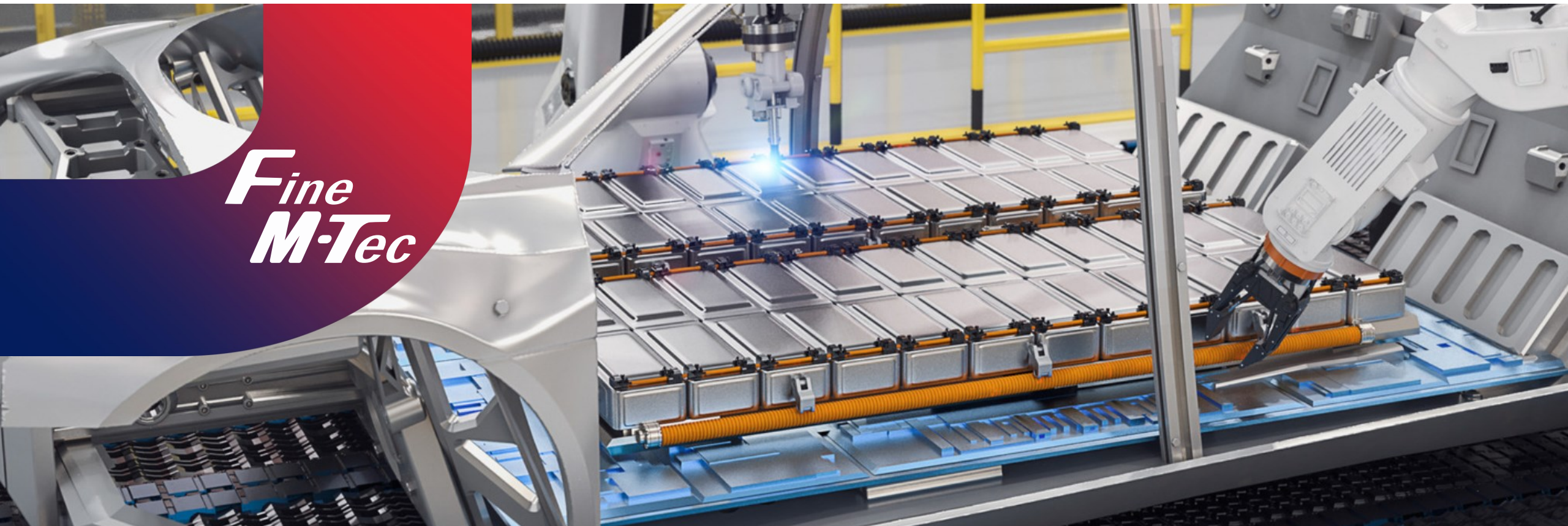
Production Facility

End Plate 공정 / VINA CNS



03 첨단 IT기기 기구부품

- 폴더블 스마트폰, 웨어러블 디바이스 등



Fine
M-Tec

첨단 IT기기 부품, 정밀 기구부품 및 모듈부품

폴더블 디바이스 · 웨어러블 디바이스

- 스마트워치 구조부품
- 무선이어폰 크래들 힌지
- 폴더블폰 힌지

당사의 Hinge 기술은 스마트폰, 태블릿, 노트북, 전장분야 등 다양한 형태로 적용 가능



시장전망

웨어러블 · 폴더블 · 소형정밀

- AI · 헬스케어 탑재로 교체주기 단축
- 2026 보급형 폴더블 출시로 대중화 모멘텀 예상

신규모빌리티

- 커넥티드카/로봇가전/XR 기기 확산 → 경량 · 정밀 메커니즘 수요 증가 전망

신규 Lifestyle & Smart Devices(추진사업)

- 로봇 청소기 구조부품, VR/AR 구조부품

당사의 정밀 가공기술 및 다이내믹 구조부품 제조기술 기반으로 영역 확대 중



의료기기분야

- '25년 라인셋업 및 인증 절차 완료 예정
- '26년 상반기 양산 목표로 진행중

*해당 제품군은 고객사와 체결한 비밀유지계약(NDA)에 따라 구체적 정보 공개가 제한되어 있습니다.

*상기 이미지는 이해를 돕기 위한 예시로, 고객사NDA(비밀유지계약)준수를 위해 실제 부품 이미지와상이합니다.

융복합 기술과 최고의 메커니즘으로 미래를 선도하는 IT부품기업

주주가치를 위해 최선을 다하겠습니다.

THANK YOU

The logo for Fine M-Tec, featuring the word "Fine" in a stylized font above "M-Tec".

THE **INVESTOR RELATIONS** OF FINE M-TEC 2025